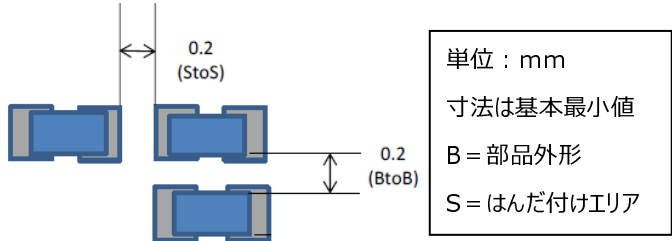


< (KMD) 表面実装(SMT)仕様 >

◆必要なデータ	①部品表 (excel)	
	②基板寸法図・板厚・取り数	
	③部品配置図 (HPGL、DXF ファイル)	
	④メタルマスク用ガーバーデータ (HPGL、DXF ファイル) ※ご支給の場合は除く	
	⑤実装部品 X Y 座標リスト (TXT ファイル)	
◆メタルマスク	一般標準サイズの 650×550mm 枠厚 30mmを使用致します。 使用後のメタルマスクにつきましては、実装基板納品時に一緒に納品させていただきます。	
◆実装	SMD 梱包形態	リール 必須 (8mm～24mm 幅 紙及びエンボステーピングリールΦ180～Φ330mm)
	異形部品梱包形態	トレイ (L335mm × W230mm × H25mm)
	BGA / CSP / LGA / QFN 梱包形態	トレイ (L335mm × W230mm × H25mm)
	DIP 部品 梱包形態	リフロー実装不可 (手はんだ付け対応になります) 梱包形態につきましては、特に指定はございません。 但し、足が曲がる可能性のある部品については、足が曲がらないようトレイ等に載せるなどしてのご支給お願い致します。
◆基板	基板サイズ	MIN 50mm×50mm～ MAX 330mm×250mm t = 0.5mm以上 ※キャリア対応で小基板対応が可能になる場合があります。
	実装エリア	MIN 50mm×50mm～ MAX 330mm×240mm
	材質	ガラエポ (FR4、CEM3 等)。その他については、お問合せ願います。 FPC も実装可能です。但し搬送用キャリアが必要になりますので、その際は、お問合せ願います。
	表面処理	耐熱フラックス処理、Au フラッシュ処理、はんだレベラー処理に対応。 表面処理無し (銅箔のみ) 基板は実装サービス対応不可となります。
	認識マーク	形状：○、□等      サイズ：0.5～2.0mm 基板の対角に2点以上配置願います。 認識マークの背景にはそのマークと異なる 0.2mm 以上の不干渉エリアが必要です。
	バットマーク	○又は□の 3mm 以上のマークが必要です。
	部品配置	部品隣接間寸法 下図の通りです。 

◆ソルダーペースト	弊社指定の鉛フリーはんだ	弊社都合により変更になる可能性有ります。 お問合せをお願いします。
<p>◆リフロープロファイル</p> <div data-bbox="440 241 1120 577" style="text-align: center;"> <p>リフロー炉温度プロファイル</p> </div> <p>プロファイル取得 及び 実装機プログラム作成の為、試作枚数の他にサンプル基板を2枚程度ご準備お願い致します。</p>		
◆外観検査 目視検査となります。	外観基準	JIS C61191 プリント配線板実装 に準拠。  ※外観検査は、製品の機能性を保証するものではありません。

【基板・部品についてのご注意事項】

はんだ付けする基板表面 及び 部品端子部は、素手又は指で触らないでください。

【ご注文上の注意事項】

注文決定後のご支給品予定の部品不足があり、未実装となった場合でも、試作準備工数が既に発生しておりますので、ご請求金額からその分のお値引きはされませんので、予めご了承お願い致します。

【弊社での部品調達時のご注意】

- ◆すべての部品の調達を保証するものではありません。
- ◆部品表記載の型番は、サフィックスを含め正確に記載してください。
- ◆弊社では、部品の代替提案等は原則行っておりません。